

2011年2月15日

## モバイルプラットフォーム「MP5225」の仕様概要

項目	仕様
プラットフォーム構成	OS や U/I、各種マルチメディアを実現するアプリケーションプロセッサ 「SH-Mobile APE5R」と3G 他の通信機能を実現するモデムプラットフォームから構成されるモバイルプラットフォーム。
メインプロセッサ	Cortex A9 Dual Core、6000DMIPS
ビデオ & グラフィックス機能	フル HD ビデオエンコード & デコード機能 (H.264、VC-1、VP6 など) Open GL ES、Open VG 対応、JPEG 対応
サウンド機能	Speech Codec、MP3 など各種フォーマットをサポート
ディスプレイ機能	2つの LCD、HDMI などの外部ディスプレイの同時オペレーションが可能。
BT/WLAN/FM-Radio GPS	各種外付けモジュールをフレキシブルに対応可能。
インタフェース	USB2.0、SPI/I2C/UART、MIPI-HSI、MIPI-DSI、MIPI-CSI2、SDIO、eMMCver4.4、TSIF、SIM インタフェース等
モデム機能	各種モデムプラットフォームをサポート 下記は、ルネサス LTE トリプルモードモデムプラットフォーム SP2531 の場合
モデム機能 通信機能概要	LTE access 3GPP Release 8, LTE FDD/TDD <ul style="list-style-type: none"> <li>•LTE UE Class 3</li> <li>•Down Link 100 Mbps and Up link 50 Mbps</li> <li>•MIMO (2x2/4x2) and RX diversity</li> <li>•Flexible bandwidth (1.4 - 20 MHz)</li> <li>•CS Fallback Voice, Single Radio VCC</li> </ul>
	HSPA access 3GPP Release 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>•Down link 42 Mbps</li> </ul>

項目	仕様
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HSDPA Cat. 20 (MIMO &amp; 64QAM)</li> <li>•HSDPA Cat. 24 (DC &amp; 64QAM)</li> <li>•Up link 11.5 Mbps</li> <li>•HSUPA Cat. 7 (16QAM)</li> <li>•HSUPA DC (Dual Cell)</li> <li>•CPC and CS over HS</li> </ul> <hr/> GSM access 3GPP Release 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>•GSM Quad Band GSM850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS1900</li> <li>•DTM Multi Slot Class 33</li> </ul>
ルネサスモバイル社製 主要 LSI	アプリケーションプロセッサ (SH-Mobile APE5R)、 & SP2531 等 (ベースバンド LSI、RF トランシーバ IC、 電源 IC、パワーアンプ)
上記チップセット サンプル価格	99 米ドル (約 8100 円、1 ドル=82 円)

以上